

# 2018-2023年中国芯片产业市场发展需求调研与未来发展前景预测报告

报告大纲

观研报告网

[www.chinabaogao.com](http://www.chinabaogao.com)

## 一、报告简介

观研报告网发布的《2018-2023年中国芯片产业市场发展需求调研与未来发展前景预测报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/yuanqijian/297936297936.html>

报告价格：电子版: 7200元 纸介版：7200元 电子和纸介版: 7500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、报告目录及图表目录

芯片产业具备战略性、先导性和基础性，中国“芯”奋起直追

发达国家的 ICT 产业建立在强势的芯片基础之上。芯片产业是一国工业的支柱之一，其下游的 ICT 产业在美、日、韩等发达国家中的地位尤为重要。我们耳熟能详的诸多公司，如美国的谷歌、IBM、Intel、微软、Apple、AT&T、英伟达，韩国的三星，日本的 Sony、东芝等都属于 ICT 领域，每年能贡献超百亿美元的利润。这些公司或是自身的产品或是上游均是芯片行业，本国芯片产业的强势不仅让这些公司站稳了脚跟，对其国内人工智能、信息安全、网络建设等诸多领域的推动作用更是不言而喻。

IC 产业是国家战略性、先导性、基础性行业，对信息安全、“互联网+”建设和人工智能等战略的发展必不可少。芯片是 ICT 产业的底层硬件，没有芯片的国产化，就更不用说建立于其之上的 ICT 产业，对我国“互联网+”建设和人工智能战略等新一代信息技术发展乃至国家信息安全造成了巨大影响。中国虽然是世界的制造工厂，是全球个人计算机、手机、家电以及其他多种电子设备的第一大制造国，全球约有 90% 的个人笔记本电脑及智能手机和大量的电子设备在中国制造，但我国的芯片自给率仍在 10% 左右，与我国的终端制造规模、发展速度相当不匹配，芯片产业的弱势制约了国内电子信息产品的竞争力，压缩了行业利润。所以国家无论从科技战略发展的角度还是从国内实体经济的角度考虑，都必不可少要重点发展芯片产业。国家在 2014 年发布的国家战略性、基础性、先导性行业发展。

我国集成电路进口额占全球市场份额超 6 成，逆差近年稍有稳定 海思等企业逐渐崛起，中国“芯”在不断追赶。近几年，尽管全球芯片产业仍由 Intel、高通、英伟达等巨头把持，我国芯片产业仍呈现出蓬勃的发展力，近三年行业销售额复合增长率超 20%。2009 年全球纯芯片设计公司 50 强中，中国第一家闯入世界 50 强的是华为旗下的海思公司，而 2014 年这个数目达到了 9 家，2016 年增长到了 11 家，分别是海思、紫光展讯，紫光锐迪科、中兴、大唐、南瑞、华大、ISSI、瑞芯微、全志和澜起科技。此外，虽然 2016 年全球前 20 最大半导体公司中没有中国企业的身影，但是其门槛 44.55 亿美元与海思 2016 年的收入基本相当，而表中的不少公司营收增速非常缓慢，尤其是排名居后的 4 家增速基本在 0% 附近，明年海思有望进入全球前 20 强。

国内芯片产业销售额保持 20% 增速 进入全球前 50 的企业数迅速上升 海思今年有望进入全球半导体前 20 强

AI 芯片形成突破，战略级政策频吹春风，助力弯道超车 ASIC 摆脱传统包袱突破桎梏。2016 年 6 月，中星微发布国内首款嵌入式 NPU(神经网络处理器)芯片，并应用于全球首款嵌入式视频处理芯片“星光智能一号”。同样在 2016 年，今年成为全球人工智能芯片领域唯一独角兽公司的“寒武纪”发布了“DIANNAO”系列的首个型号，至今已有三代，其背后的机理和指令集更是被同行广泛引用。公司也成为全球第一个成功流片并拥有成熟产品的 AI 芯片公

司，而随着华为麒麟970装配上了其1A型号的芯片，寒武纪芯片在智能终端的商用已在迅速推进。这样的突破在国内传统的集成电路行业是难以想象的。

ASIC芯片存在竞争空间，国内应用市场较大，有望以点及面助力AI芯片弯道超车。如果说在芯片产业上ARM对X86架构的反击制衡成就于移动终端的兴起，那么AI浪潮之下，AI芯片尤其是专用于深度学习的ASIC，用以点及面的方式实现跨越式发展，未尝不是一个弯道超车的好机会。我们可以看到，竞争空间上，传统的CPU领域有Intel、高通，GPU领域有英伟达，FPGA中有Xilinx和Altera，唯有与人工智能计算最为定制化结合的ASIC领域尚未有绝对的垄断性龙头；应用场景上，ASIC适用于终端设备，而中国国内安防空间巨大，国产智能手机出货量也占据了全球近半壁江山，新零售产业的发展也位居全球前列，潜在的市场十分巨大。

政策频频吹春风，中国“芯”有望大步向前。近几年国家对人工智能和人工智能芯片产业给予了战略层面的关注，从2014年发布《国家集成电路产业发展推进纲要》将IC产业视为国家战略性、基础性、先导性行业发展，包括《中国制造2025》、《“互联网+”指导意见》、《“十三五”规划》等多份国家级战略文件中都特别提出了人工智能芯片、类脑计算的发展方向。其中，《中国制造2025》提出2020年中国芯片自给率要达到40%，2025年要达到50%；2017年7月发布的《新一代人工智能发展规划》更要求人工智能核心产业到2030年达到1万亿，带动相关产业规模超过10万亿。政策对IC产业提出高要求的同时也表明了国家的重视度，人工智能和芯片行业同时作为国家级战略的，AI芯片产业有望引领中国“芯”大步向前。

### 近三年部分 AI+芯片产业支持政策

终端引领 ASIC 芯片落地浪潮，国产化趋势或带来发展良机 豪强纷纷出手，智能手机、可穿戴设备、安防前端等均可能成为ASIC芯片落地放量的先行地。AI芯片尤其是ASIC芯片由于其低功耗高效率的特点特别适用于功耗较低，空间较小的智能手机、智能安防摄像头、智能家居、无人机等智能终端，这些领域可能成为ASIC芯片率先放量之处。手机端对于及时性的高要求让移动端AI芯片成为必需品，近期华为发布了搭载寒武纪芯片的麒麟970，苹果发布内置神经网络引擎的A11 Bionic，对移动端AI芯片产业起到推波助澜的作用。

智能技术在安防行业的应用也非常广泛，目前安防行业倾向于使用前端智能摄像头与后端处理平台结合的方式提高分析效率，如海康的摄像机就配备了Movidius开发的视觉处理器和英伟达Jetson芯片。

国产化趋势或带来发展良机。国产化趋势下，安防、智慧城市等由政府推动的敏感性行业的采购清单倾向于国产商品，智能芯片作为底层核心硬件将会受到特别关注。国内芯片产

业已有多个企业跻身全球前50强，寒武纪、地平线机器人等企业的AI芯片研发能力全球领先；华为、紫光等企业在芯片行业的体量也十分巨大。随着国内优势企业的发展，以及国家对芯片自给率政策要求的推动下，芯片逐步国产化将为国内企业带来发展良机。AI芯片作为实现人工智能领域的重中之重，其国内的市场前景十分广阔。

## 部分终端产品对AI芯片的应用

中国报告网发布的报告书内容严谨、数据翔实，更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、市场前景、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

### 【报告目录】

#### 第一部分行业环境透视

##### 第一章芯片行业薪酬构成细项解析

###### 第一节定义

###### 第二节基本工资

###### 第三节补贴

###### 第四节变动收入

###### 第五节福利

#### 第二章芯片行业薪酬环境分析

##### 第一节宏观经济概况

###### 一、宏观经济指数

###### 二、人才市场情况

###### 三、重点城市职工工资情况分布

##### 第二节人工成本报告

###### 一、人工成本数据

###### 二、劳动报酬数据

### 第三节薪资政策报告

#### 一、调薪政策

#### 二、调薪幅度

### 第四节管理人员/专业技术人员/生产服务技能人员薪酬水平报表

#### 一、管理人员薪酬水平

#### 二、专业技术人员薪酬水平

#### 三、生产服务技能人员薪酬水平

#### 四、市场薪酬结构

### 第二部分行业运行现状

## 第三章芯片行业薪酬管理方法论

### 第一节薪酬管理五个原则

#### 一、依据战略

#### 二、公平原则

#### 三、竞争原则

#### 四、激励原则

#### 五、经济原则

### 第二节薪酬管理现状快速诊断分析之五大维度

#### 一、内部公平性

#### 二、激励性

#### 三、外部竞争性

#### 四、经济性

#### 五、薪酬策略

### 第三节4D构建模型

#### 一、职位差异

#### 二、市场差异

#### 三、能力差异

#### 四、绩效差异

### 第四节4E构建模型

#### 一、内部公平性

#### 二、外部公平性

#### 三、个体公平性

#### 四、组织公平性

## 第四章芯片行业薪酬管理诊断指标展示(一个定性，四个定量)

## 第一节定性分析

### 第二节定量分析

#### 一、内部公平性

##### 1、部门人均工资和部门总收入占比

##### 2、内部绝对和相对薪酬差距分析

##### 3、不同等级员工的薪酬内部竞争力

##### 4、不同职类员工的薪酬内部竞争力

#### 二、外部竞争性

##### 1、等级薪酬外部竞争力

##### 2、职类薪酬外部竞争力

##### 3、岗位薪酬外部竞争力

##### 4、补充福利外部竞争力

#### 三、激励性

##### 1、不同职类的薪酬构成

##### 2、不同层级的薪酬构成

##### 3、人力资本投资回报

##### 4、主动离职率

#### 四、经济性

##### 1、薪酬福利占营业收入的比例

##### 2、薪酬福利占营业支出的比例

##### 3、奖金占薪酬总额的比例

##### 4、薪酬福利总额增长率

## 第五章芯片行业薪酬人力资源管理现状

### 第一节付薪理念

### 第二节企业关键核心层级、部门和岗位梳理

### 第三节现阶段各层级、职类薪酬定位

### 第四节等级薪酬制度分析

### 第五节薪酬增长分析

### 第六节福利项目实施情况分析

### 第七节员工离职率分析

### 第八节其他人力资源管理问题分析

## 第六章芯片行业等级薪酬分析

### 第一节基本薪酬等级回归分析

## 第二节固定薪酬等级回归分析

### 第三节总现金等级回归分析

### 第四节整体薪酬等级回归分析

## 第三部分竞争格局分析

## 第七章芯片行业薪酬内部公平性分析

### 第一节关键核心层级分析

### 第二节关键核心部门分析

### 第三节关键核心岗位分析

### 第四节各层级薪酬定位

### 第五节部门人均工资和总收入占比

### 第六节内部薪酬差距分析

### 第七节等级薪酬内部分析

### 第八节职类薪酬内部分析

## 第八章芯片行业薪酬外部竞争性分析

### 第一节等级薪酬外部竞争性分析

### 第二节等级薪酬散点分析

### 第三节职类薪酬外部竞争性分析

### 第四节岗位薪酬外部竞争性分析

### 第五节岗位薪酬偏离度统计分析

### 第六节补充福利竞争性分析

### 第七节薪酬调整建议

## 第九章芯片行业薪酬激励性

### 第一节职类薪酬构成

### 第二节层级薪酬构成

### 第三节人力资本投资回报

### 第四节主动离职率

## 第十章芯片行业薪酬经济性分析

### 第一节薪酬总额占营业收入比例

### 第二节薪酬总额占营业支出比例

### 第三节奖金占薪酬总额比例

### 第四节薪酬福利总额增长率



## 第十一章2015-2017年芯片行业各区域企业薪酬发展分析

### 第一节华北地区

- 一、经济发展现状
- 二、行业分布情况
- 三、企业薪酬现状

### 第二节华南地区

- 一、经济发展现状
- 二、行业分布情况
- 三、企业薪酬现状

### 第三节华中地区

- 一、经济发展现状
- 二、行业分布情况
- 三、企业薪酬现状

### 第四节东北地区

- 一、经济发展现状
- 二、行业分布情况
- 三、企业薪酬现状

### 第五节华东地区

- 一、经济发展现状
- 二、行业分布情况
- 三、企业薪酬现状

### 第六节西南地区

- 一、经济发展现状
- 二、行业分布情况
- 三、企业薪酬现状

### 第七节西北地区

- 一、经济发展现状
- 二、行业分布情况
- 三、企业薪酬现状

## 第十二章芯片行业重点企业薪酬管理现状分析

### 第一节英特尔(中国)有限公司

- (1) 企业概况
- (2) 主营业务情况分析

(3) 公司运营情况分析

(4) 公司优劣势分析

第二节三星电子株式会社

(1) 企业概况

(2) 主营业务情况分析

(3) 公司运营情况分析

(4) 公司优劣势分析

第三节高通无线通信技术(中国)有限公司

(1) 企业概况

(2) 主营业务情况分析

(3) 公司运营情况分析

(4) 公司优劣势分析

第四节德州仪器半导体技术(上海)有限公司

第四部分发展战略分析

第十三章芯片行业企业薪酬策略分析

第一节薪酬策略分类

一、薪酬水平策略

二、薪酬激励策略

三、薪酬结构策略

四、薪酬组合策略

五、薪酬总额策略

六、薪酬架构策略

七、薪酬差别策略

八、薪酬增长策略

九、薪酬支付策略

十、不同类型人员的薪酬支付策略

第二节策略管理

一、明确公司的薪酬策略

二、向员工讲明公司的涨薪理念

第十四章2018-2023芯片行业企业薪酬发展建议分析

第一节芯片行业企业薪酬研究结论及建议

第二节芯片行业企业薪酬研究结论及建议

第三节芯片行业企业薪酬竞争策略总结及建议

## 图表目录

图表：芯片薪酬行业分类表

图表：2011-2017年芯片薪酬行业总产值及占GDP比重（单位：亿元，%）

图表：我国统计上大中小微型企业划分标准（工业类）（单位：人，万元）

图表：中国企业的市场主体分类

图表：中国不同所有制性质企业的划分图表：芯片薪酬行业所处产业链示意图

图表：中国芯片薪酬主要消费群体特点分析（元）

图表：2015-2017年芯片行业管理层工资分布情况

更多图表详见正文（GSLWK）

特别说明：中国报告网所发行报告书中的信息和数据部分会随时间变化补充更新，报告发行年份对报告质量不会有任何影响，并有助于降低企事业单位投资风险。

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/yuanqijian/297936297936.html>